

Wszyscy uczestnicy postępowania

Szanowni Państwo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 17.04.2013 r.

Pytanie 1:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w przedmiarze robót (pozycja nr 8) zakłada wykonanie podkładu o grubości ok.5cm z zaprawy samopoziomującej nie gorszej niż Thomsit AGL DX. Zaprawa tego typu przeznaczona jest do wylewania na grubości max 1cm i służy tylko do wyrównywania podkładów. Czy w takiej sytuacji dopuszcza się wykonanie tradycyjnego podkładu cementowego i ewentualnie wzmocnienie jego wierzchniej warstwy zaprawą samopoziomującą, przeznaczoną do stosowania pod klej parkietowy .

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Należy zastosować zaprawy samopoziomujące przeznaczone do podkładów grubowarstwowych.

Pytanie 2:

Specyfikacja techniczna do przyklejania parkietu nakazuje zastosować klej 2-komponentowy o parametrach nie gorszych, niż wskazany jako przykład klej Thomsit P600 .Z produktów Thomsit klejem 2-komponentowym jest klej o symbolu P625.

Czy w takiej sytuacji do kosztorysu należy przyjąć klej o parametrach nie gorszych niż klej 1-komponentowy Thomsit P600, czy klej 2-komponentowy Thomsit P625.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Można zastosować klej 1-komponentowy.